

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 09-232857

(43)Date of publication of application : 05.09.1997

(51)Int.CI. H01Q 13/08
G01S 7/03
H01Q 1/27
H01Q 21/00

(21)Application number : 08-058405

(71)Applicant : TOYO COMMUN EQUIP CO LTD

(22)Date of filing : 21.02.1996

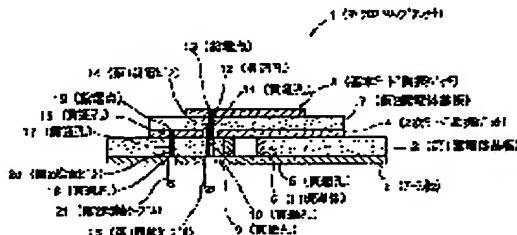
(72)Inventor : TAGUCHI YUUJIROU

(54) MICROSTRIP ANTENNA

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To secure high gain for each beam direction which is enough to cover a semi-spherical surface with a simple structure thinning the whole of an antenna and to obtain an optimum characteristic as an antenna for collision prevention to be mounted on an airplane by making the antenna have a Σ pattern and a Δ pattern as radiation patterns.

SOLUTION: On a first dielectric substrate 2 having an earth plate 3 on a lower surface side, a second order mode exciting patch 4, a second dielectric substrate 7, and a basic mode exciting patch 8 are successively laminated, the vicinity of the center of the second order mode exciting patch 4 and the earth plate 3 are connected by an annular conductor 6, further, the center conductor of a first coaxial cable 15 is connected with the power feeding point 13 of the basic mode exciting patch 8, and the center conductor of a second coaxial cable 21 is connected with the power feeding point 19 of the second order exciting patch 4.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

[decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

特開平9-232857

(43)公開日 平成9年(1997)9月5日

(51)Int.CI. ⁶ H01Q 13/08 G01S 7/03 H01Q 1/27 21/00	識別記号 H01Q 13/08 G01S 7/03 H01Q 1/27 21/00	府内整理番号 F I H01Q 13/08 G01S 7/03 H01Q 1/27 21/00	技術表示箇所 D
---	---	--	-------------

審査請求 未請求 請求項の数 7 FD (全9頁)

(21)出願番号 特願平8-58405
(22)出願日 平成8年(1996)2月21日

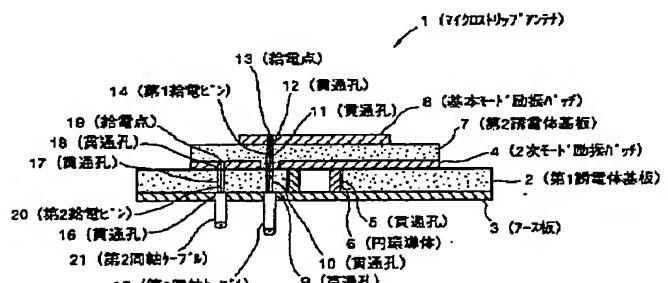
(71)出願人 000003104
東洋通信機株式会社
神奈川県高座郡寒川町小谷2丁目1番1号
(72)発明者 田口 裕二朗
神奈川県高座郡寒川町小谷二丁目1番1号
東洋通信機株式会社内
(74)代理人 弁理士 鈴木 均

(54)【発明の名称】マイクロストリップアンテナ

(57)【要約】

【課題】 本発明は、アンテナ全体を薄形にした簡単な構造で、半球面をカバーするのに充分な各ビーム方向に対して、高い利得を確保するとともに、放射パターンとして、Σパターンと、△パターンとを持たせて、航空機などに搭載される衝突防止用アンテナとして最適な特性にする。

【解決手段】 下面側にアース板3を持つ第1誘電体基板2上に、2次モード励振パッチ4、第2誘電体基板7、基本モード励振パッチ8を順次、積層するとともに、円環導体6によって2次モード励振パッチ4の中心付近とアース板3とを接続し、さらに第1同軸ケーブル15の中心導体を基本モード励振パッチ8の給電点13に接続するとともに、第2同軸ケーブル21の中心導体を2次モード励振パッチ4の給電点19に接続する。



【特許請求の範囲】

【請求項 1】 下面にアース板を持つ第1誘電体基板と、下面に高次モード励振パッチを持つとともに上面に基本モード励振パッチを持ち且つ前記第1誘電体基板上に積層される第2誘電体基板と、
前記基本モード励振パッチ、高次モード励振パッチのいずれかを送受信パッチ（放射導体）として使用することを特徴とするマイクロストリップアンテナ。

【請求項 2】 下面にアース板を持つ第1誘電体基板と、

下面に2次モード励振パッチを持ち、上面に基本モード励振パッチを持ち、前記第1誘電体基板状に積層される第2誘電体基板と、

前記基本モード励振パッチ、2次モード励振パッチのいずれかを送受信パッチ（放射導体）として使用することを特徴とするマイクロストリップアンテナ。

【請求項 3】 請求項 1 又は 2 に記載のマイクロストリップアンテナにおいて、

前記第2誘電体基板の下面に設けられている高次モード或いは2次モード励振パッチの中心点を中心する円周部分と、前記第1誘電体基板に下面に設けられているアース板とを円環導体または円柱導体または複数のスルーホールによって電気的に接続したことを特徴とするマイクロストリップアンテナ。

【請求項 4】 下面にアース板を持つ第1誘電体基板と、

下面に基本モード励振パッチを持つと共に、上面に高次モード励振パッチを持ち、且つ前記第1誘電体基板上に積層される第2誘電体基板と、

前記基本モード励振パッチ、高次モード励振パッチのいずれかを送受信パッチ（放射導体）として使用することを特徴とするマイクロストリップアンテナ。

【請求項 5】 下面にアース板を持つ第1誘電体基板と、

下面に基本モード励振パッチを持ち、上面に2次モード励振パッチを持ち、前記第1誘電体基板上に積層される第2誘電体基板と、

前記基本モード励振パッチ、2次モード励振パッチのいずれかを送受信パッチ（放射導体）として使用することを特徴とするマイクロストリップアンテナ。

【請求項 6】 請求項 1 乃至 5 のいずれかに記載のマイクロストリップアンテナにおいて、

前記第1、第2誘電体基板の少なくともいずれか一方をペーパーハニカム材によって構成したことを特徴とするマイクロストリップアンテナ。

【請求項 7】 請求項 1 ~ 6 のいずれかに記載のマイクロストリップアンテナにおいて、基本モード励振パッチ及び高次モード或いは2次モード励振パッチの両者を同時に送受信パッチ（放射導体）として使用したことを特徴とするマイクロストリップアンテナ。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、カバーレンジを拡大したマイクロストリップアンテナに関する。

【0002】

【従来の技術】 薄形、軽量、低姿勢などの特徴を持つマイクロストリップアンテナは、移動体用のアンテナとして適し、さらに量産性についても優れていることから、今後、広く普及するものと思われる。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】 ところで、このような通信システムのうち、人工衛星を介して地上局と、移動体との間の通信をサポートする通信システムでは、移動体用アンテナとして、地球の半球面をカバーすることが要求されていることから、図6に示す如く多面体101の各面103上に各々、図7に示す如く下面にアース板105を持つ誘電体基板104上に所定の形状、例えば円形に形成された導電体によって構成される励振パッチ106を設け、アンテナ面に対して垂直方向に主ビーム107を持つマイクロストリップアンテナ102を取付け、これらの各マイクロストリップアンテナ102を切り換えて使用して、半球面をカバーする方法などがとられている。しかしながら、このような方法では、実際の通信を行なう際、各マイクロストリップアンテナ102のうち、人工衛星と対向する1つのマイクロストリップアンテナ102しか、通信に使用できないことから、アンテナの占有面積が増えるとともに、アンテナ重量も増えてしまい、移動体用アンテナとして不適なものになってしまうという問題があった。

【0004】 また、移動体として、航空機を考えると、このような方法で構成されたアンテナでは、マイクロストリップアンテナ102が搭載されている多面体101の上部部分が航空機の機体面から飛び出して、その分だけ空気抵抗が増えてしまい、燃費が悪くなってしまうという問題があった。また、特開平2-184101号公報では、上記の問題点等を解決するため、下面にアース板をもつ誘電体基板上に円環パッチとその内側の円形パッチで構成されたアンテナが提案されている。しかし、このアンテナは文献：J. R. James & P. S. H

40 all : Handbook of MicrostriplAntennas, Volume 1, 1989, Peter Peregrinus Ltd, London

の169ページ下3行目に記述されているように、本質的に、円環パッチの径は円形パッチの径よりも小さい。具体的には181ページ表3、4に記載されている通り、設計周波数 $f = 2 \text{ GHz}$ 、誘電体基板の厚さ $t = 1.59 \text{ mm}$ 、その比誘電率 $\epsilon_r = 2.32$ のとき円形パッチの半径 $a = 4.92 \text{ cm}$ に対して、高次モード $T_{M_{11}}$ の円環パッチの内径 $a = 4.45 \text{ cm}$ となり、円形パッチを円環パッチの内側に配置することは不可能であ

る。

【 0 0 0 5 】以上、この文献からも明らかなように、上記のアンテナを設計することは实际上極めて困難であるという問題点があった。

【 0 0 0 6 】本発明は上記の事情に鑑み、アンテナ全体を薄形にした簡単な構造で、半球面をカバーするのに充分な利得を確保することができ、これによってアンテナの占有面積、アンテナ重量を小さくすることができ、移動体用アンテナとして要求される特性にすることができ、さらにアンテナ自身の放射パターンとして、初めからΣ（サム）パターンと、△（デフ）パターンとを持たせることができ、これによってパターン合成回路を使用することなく、極めて低い姿勢にすることができ、これによって航空機などに搭載されるアンテナとして最適な特性にすることができるマイクロストリップアンテナを提供することを目的としている。

【 0 0 0 7 】

【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するために本発明によるマイクロストリップアンテナは、請求項1では、下面にアース板を持つ第1誘電体基板と、下面に高次モード励振パッチを持つとともに上面に基本モード励振パッチを持ち且つ前記第1誘電体基板上に積層される第2誘電体基板と、前記基本モード励振パッチ、高次モード励振パッチのいずれかを送受信パッチ（放射導体）として使用することを特徴とする。

【 0 0 0 8 】請求項2では、下面にアース板を持つ第1誘電体基板と、下面に2次モード励振パッチを持ち、上面に基本モード励振パッチを持ち、前記第1誘電体基板状に積層される第2誘電体基板と、前記基本モード励振パッチ、2次モード励振パッチのいずれかを送受信パッチ（放射導体）として使用することを特徴とする。

【 0 0 0 9 】請求項3では、請求項1又は2に記載のマイクロストリップアンテナにおいて、前記第2誘電体基板の下面に設けられている高次モード或いは2次モード励振パッチの中心点を中心する円周部分と、前記第1誘電体基板に下面に設けられているアース板とを円環導体または円柱導体または複数のスルーホールによって電気的に接続したことを特徴とする。

【 0 0 1 0 】請求項4では、下面にアース板を持つ第1誘電体基板と、下面に基本モード励振パッチを持つと共に、上面に高次モード励振パッチを持ち、且つ前記第1誘電体基板上に積層される第2誘電体基板と、前記基本モード励振パッチ、高次モード励振パッチのいずれかを送受信パッチ（放射導体）として使用することを特徴とする。

【 0 0 1 1 】請求項5では、下面にアース板を持つ第1誘電体基板と、下面に基本モード励振パッチを持ち、上面に2次モード励振パッチを持ち、前記第1誘電体基板上に積層される第2誘電体基板と、前記基本モード励振パッチ、2次モード励振パッチのいずれかを送受信パッ

チ（放射導体）として使用したことを特徴とする。

【 0 0 1 2 】請求項6では、請求項1乃至5のいずれかに記載のマイクロストリップアンテナにおいて、前記第1、第2誘電体基板の少なくともいいずれか一方をベーパーハニカム材によって構成したことを特徴とする。

【 0 0 1 3 】請求項7では、請求項1～6のいずれかに記載のマイクロストリップアンテナにおいて、基本モード励振パッチ及び高次モード或いは2次モード励振パッチの両者を同時に送受信パッチ（放射導体）として使用したことを特徴とする。

【 0 0 1 4 】

【発明の実施の形態】以下、本発明を図面に示した形態例に基づいて詳細に説明する。

《第1形態例の構成》図1は本発明によるマイクロストリップアンテナの第1形態例を示す断面図である。この図に示すマイクロストリップアンテナ1は、所定の比誘電率、厚さを持つ方形状の板状部材によって構成される第1誘電体基板2と、この第1誘電体基板2の下面に貼付された導体板などによって構成されるアース板3と、

20 図2に示す如く所定の直径を持つ円形状の導体板によって構成され、前記第1誘電体基板2の上面側に固定される2次モード励振パッチ4と、前記第1誘電体基板2に形成された貫通孔5に挿入されて前記アース板3と前記2次モード励振パッチ4の中心点付近とを電気的に接続する円環導体6と、所定の比誘電率、厚さを持つ方形状の板状部材によって構成され、前記2次モード励振パッチ4の上面側に固定される第2誘電体基板7と、所定の直径を持つ円形状の導体板によって構成され、第2誘電体基板7の上面側に固定される基本モード励振パッチ8とを備えている。

【 0 0 1 5 】さらに、このマイクロストリップアンテナ1は、前記アース板3、前記第1誘電体基板2、前記2次モード励振パッチ4、第2誘電体基板7、基本モード励振パッチ8に形成された各貫通孔9、10、11、12に挿入され、上端部分が前記基本モード励振パッチ8の給電点13に接続される第1給電ピン14と、外側導体の先端が前記アース板3に接続され、中心導体が前記第1給電ピン14の下端部分に接続される第1同軸ケーブル15と、前記アース板3、前記第1誘電体基板

40 2、2次モード励振パッチ4に形成された各貫通孔16、17、18に挿入され、上端部分が前記2次モード励振パッチ4の給電点19に接続される第2給電ピン20と、外側導体の先端が前記アース板3に接続され、中心導体が前記第2給電ピン20の下端部分に接続される第2同軸ケーブル21とを備えている。なお、第1給電ピン14と第2給電ピン20は、それぞれ第1同軸ケーブル15の中心導体、第2同軸ケーブル21の中心導体で代用しても良い。前記基本モード励振パッチ8の径および2次モード励振パッチ4の径は、設計周波数に応じて一義的に決定され、基本モード励振パッチ8の径に対

して、2次モード励振パッチ4の径が約1.7倍に設定される。

【0016】《第1形態例の動作》次に、図1に示す断面図、図2に示す斜視図を参照しながら、この形態例の動作について説明する。まず、第1、第2同軸ケーブル15、21のうち、第1同軸ケーブル15を介して、送受信回路（図示は省略する）とマイクロストリップアンテナ1とが接続されているときには、前記送受信回路のアース端子が第1同軸ケーブル15の外側導体、アース板3、円環導体6を介して2次モード励振パッチ4に接続されるとともに、前記送受信回路の信号端子が前記第1同軸ケーブル15の中心導体、第1給電ビン14を介して基本モード励振パッチ8の給電点13に接続される。この結果、送受信回路から高周波信号が出力され、これが第1同軸ケーブル15を介してマイクロストリップアンテナ1に供給されたとき、2次モード励振パッチ4がマイクロストリップアンテナ1のアース板として機能するとともに、基本モード励振パッチ8がマイクロストリップアンテナ1の送受信パッチ（放射導体）として機能して、図3(a)に示す如くアンテナ面に対して、垂直な方向（法線方向）にΣ（サム）型の放射パターンを持つ主ビーム25が発生し、この主ビーム25の方向に対して、前記高周波信号に対応する電波が送信される。

【0017】この状態で、前記主ビーム25の方向から電波が到来すれば、2次モード励振パッチ4がマイクロストリップアンテナ1のアース板として機能して、基本モード励振パッチ8に受信信号が励起され、これが給電点13、第1給電ビン14、第1同軸ケーブル15の中心導体を介して、前記送受信回路の信号端子に供給される。また、第1、第2同軸ケーブル15、21のうち、第2同軸ケーブル21を介して、送受信回路（図示は省略する）とマイクロストリップアンテナ1とが接続されているときには、前記送受信回路のアース端子が第2同軸ケーブル21の外側導体を介してアース板3に接続されるとともに、前記送受信回路の信号端子が前記第2同軸ケーブル21の中心導体、第2給電ビン20を介して2次モード励振パッチ4の給電点19に接続される。

【0018】この結果、送受信回路から高周波信号が出力され、これが第2同軸ケーブル21を介してマイクロストリップアンテナ1に供給されたとき、第1誘電体基板2の下面に設けられたアース板3がマイクロストリップアンテナ1のアース板として機能し、円環導体6がセンタービンとして機能するとともに、2次モード励振パッチ4が送受信パッチ（放射導体）として機能して、図3(b)に示す如くアンテナ面に対して、低仰角な方向に△（デフ）型の放射パターンを持つ主ビーム26が発生し、この主ビーム26の方向に対して、前記高周波信号に対応する電波が送信される。この状態で、前記主ビーム26の方向から電波が到来すれば、アース板3がマ

イクロストリップアンテナ1のアース板として機能して、2次モード励振パッチ4に受信信号が励起され、これが給電点19、第2給電ビン20、第2同軸ケーブル21の中心導体を介して、前記送受信回路の信号端子に供給される。

【0019】《第1形態例の効果》このように、この第1形態例では、下面側にアース板3を持つ第1誘電体基板2上に、2次モード励振パッチ4、第2誘電体基板7、基本モード励振パッチ8を順次、積層するとともに、円環導体6によって2次モード励振パッチ4の中心付近とアース板3とを接続し、さらに第1同軸ケーブル15の中心導体を基本モード励振パッチ8の給電点13に接続するとともに、第2同軸ケーブル21の中心導体を2次モード励振パッチ4の給電点19に接続するようにしたので、第1同軸ケーブル15を使用してマイクロストリップアンテナ1と、送受信回路とを接続したとき、アンテナ面に対して垂直な方向に主ビーム25を発生させ、この主ビーム25の方向に対し、高い利得で送受信させることができ、また第2同軸ケーブル21を使用してマイクロストリップアンテナ1と、送受信回路とを接続したとき、低仰角方向に主ビーム26を発生させ、この主ビーム26の方向に対し、高い利得で送受信させることができる。通信方向がアンテナ面に対して垂直な方向を中心とする方向にあるときには、第1同軸ケーブル15によってマイクロストリップアンテナ1と、送受信回路とを接続し、また通信方向がアンテナ面に対して低仰角な方向を中心とする方向にあるときには、第2同軸ケーブル21によってマイクロストリップアンテナ1と、送受信回路とを接続することにより、半球をカバーする各ビーム方向に対して、一定値以上のアンテナ利得を確保して、通信を行なうことができる。

【0020】《第2形態例の構成》図4は本発明によるマイクロストリップアンテナの第2形態例を示す断面図である。この図に示すマイクロストリップアンテナ30は、所定の比誘電率、厚さを持つ方形状の板状部材によって構成される第1誘電体基板31と、この第1誘電体基板31の下面に貼付された導体板などによって構成されるアース板32と、所定の直径を持つ円形状の導体板によって構成され、前記第1誘電体基板31の上面側に固定される基本モード励振パッチ33と、所定の比誘電率、厚さを持つ方形状の板状部材によって構成され、前記基本モード励振パッチ33を介在させた状態で前記第1誘電体基板31の上面側に固定される第2誘電体基板34と、所定の直径を持つ円形状の導体板によって構成され、前記第2誘電体基板34の上面側に固定される2次モード励振パッチ35とを備えている。さらに、このマイクロストリップアンテナ30は、前記アース板32、第1誘電体基板31、基本モード励振パッチ33に形成された各貫通孔36、37、38に挿入され、上端部分が前記基本モード励振パッチ33の給電点39に接

40 固定される基本モード励振パッチ33と、所定の比誘電率、厚さを持つ方形状の板状部材によって構成され、前記基本モード励振パッチ33を介在させた状態で前記第1誘電体基板31の上面側に固定される第2誘電体基板34と、所定の直径を持つ円形状の導体板によって構成され、前記第2誘電体基板34の上面側に固定される2次モード励振パッチ35とを備えている。さらに、このマイクロストリップアンテナ30は、前記アース板32、第1誘電体基板31、基本モード励振パッチ33に形成された各貫通孔36、37、38に挿入され、上端部分が前記基本モード励振パッチ33の給電点39に接

50

続される第1給電ピン40と、外側導体の先端が前記アース板32に接続され、中心導体が前記第1給電ピン40の下端部分に接続される第1同軸ケーブル41と、前記アース板32、第1誘電体基板31、第2誘電体基板34、2次モード励振パッチ35に形成された各貫通孔42、43、44、45に挿入され、上端部分が前記2次モード励振パッチ35の給電点46に接続される第2給電ピン47と、外側導体の先端が前記アース板32に接続され、中心導体が前記第2給電ピン47の下端部分に接続される第2同軸ケーブル48とを備えている。なお、第1給電ピン46と第2給電ピン47は、それぞれ第1同軸ケーブル41の中心導体、第2同軸ケーブル48の中心導体で代用しても良い。この場合、前記基本モード励振パッチ33の径および2次モード励振パッチ35の径は、設計周波数に応じて一義的に決定され、基本モード励振パッチ33の径に対して、2次モード励振パッチ35の径が約1.7倍に設定される。

【0021】《第2形態例の動作》次に、図4に示す断面図を参照しながら、この形態例の動作について説明する。まず、第1、第2同軸ケーブル41、48のうち、第2同軸ケーブル48が無接続状態にされるとともに、第1同軸ケーブル41を介して、送受信回路（図示は省略する）とマイクロストリップアンテナ30とが接続されているときには、前記送受信回路のアース端子が第1同軸ケーブル41の外側導体を介して、アース板32に接続されるとともに、前記送受信回路の信号端子が前記第1同軸ケーブル41の中心導体、第1給電ピン40を介して、基本モード励振パッチ33の給電点39に接続される。この結果、前記送受信回路から高周波信号が高出力され、これが第1同軸ケーブル41を介してマイクロストリップアンテナ30に供給されたとき、アース板32がマイクロストリップアンテナ30のアース板として機能するとともに、基本モード励振パッチ33がマイクロストリップアンテナ30の送受信パッチ（放射導体）として機能し、さらに2次モード励振パッチ35が無給電パッチ（無給電素子）として機能して、マイクロストリップアンテナ30がスタック型マイクロストリップアンテナとして動作する。

【0022】これによって、図5(a)に示す如くアンテナ面に対して、垂直な方向（法線方向）にΣ（サム）型の放射パターンを持つ主ビーム49が発生し、この主ビーム49の方向に対して、前記高周波信号に対応する電波が送信される。そして、この状態で、前記主ビーム49の方向から電波が到来すれば、アース板32がマイクロストリップアンテナ30のアース板として機能し、さらに2次モード励振パッチ35がマイクロストリップアンテナ30の無給電パッチ（無給電素子）として機能して、基本モード励振パッチ33に受信信号が励起され、これが給電点39、第1給電ピン40、第1同軸ケーブル41の中心導体を介して、前記送受信回路の信号

端子に供給される。この際、既に出願した明細書（特願昭63-114451号の明細書）に記載しているように、この主ビーム49が極めて広帯域な周波数特性を持つことから、広い周波数範囲に渡って、電波の送受信を行なうことができる。

【0023】また、第1、第2同軸ケーブル41、48のうち、第1同軸ケーブル41が無接続状態にされるとともに、第2同軸ケーブル48を介して、送受信回路（図示は省略する）とマイクロストリップアンテナ30とが接続されているときには、送受信回路のアース端子が第2同軸ケーブル48の外側導体を介して、アース板32に接続されるとともに、前記送受信回路の信号端子が前記第2同軸ケーブル48の中心導体、第2給電ピン47を介して、2次モード励振パッチ35の給電点46に接続される。このため、送受信回路から高周波信号が高出力され、これが第2同軸ケーブル48を介してマイクロストリップアンテナ30に供給されたとき、第1誘電体基板31の下面に設けられたアース板32がマイクロストリップアンテナ30のアース板として機能し、第1、第2誘電体基板31、34がマイクロストリップアンテナ30の誘電体基板として機能するとともに、2次モード励振パッチ35が送受信パッチ（放射導体）として機能する。

【0024】このため、第1、第2誘電体基板31、34の厚さ分だけ、2次モード励振パッチ35と、アース板32との間隔が広くなるので、広帯域特性となり、図5(b)に示す如くアンテナ面に対して、低仰角な方向に△（デフ）型の放射パターンを持つ主ビーム50が発生し、この主ビーム50の方向に対して、前記高周波信号に対応する電波が送信される。この状態で、前記主ビーム50の方向から電波が到来すれば、アース板32がマイクロストリップアンテナ30のアース板として機能して、2次モード励振パッチ35に受信信号が励起され、これが給電点46、第2給電ピン47、第2同軸ケーブル48の中心導体を介して、前記送受信回路の信号端子に供給される。

【0025】《第2形態例の効果》このように、この第2形態例では、下面側にアース板32を持つ第1誘電体基板31上に、基本モード励振パッチ33、第2誘電体基板34、2次モード励振パッチ35を順次、積層し、さらに第1同軸ケーブル41の中心導体を基本モード励振パッチ33の給電点39に接続されるとともに、第2同軸ケーブル48の中心導体を2次モード励振パッチ35の給電点46に接続するようにしたので、第1同軸ケーブル41を使用してマイクロストリップアンテナ30と、送受信回路とを接続したとき、アンテナ面に対して垂直な方向に主ビーム49を発生させ、この主ビーム49の方向に対して高い利得で送受信させることができ、また第2同軸ケーブル48を使用してマイクロストリップアンテナ30と、送受信回路とを接続したとき、低仰

角方向に主ビーム 50 を発生させ、この主ビーム 50 の方向に対して高い利得で送受信させることができる。このため、通信方向がアンテナ面に対して垂直な方向を中心とする方向にあるときには、第 1 同軸ケーブル 41 によってマイクロストリップアンテナ 30 と、送受信回路とを接続し、また通信方向がアンテナ面に対して低仰角な方向を中心とする方向にあるときには、第 2 同軸ケーブル 48 によってマイクロストリップアンテナ 30 と、送受信回路とを接続することにより、半球をカバーする各ビーム方向に対して、広帯域周波数特性で、一定値以上のアンテナ利得を確保して、通信を行なわせることができる。

【0026】《他の形態例》また、上述した第 1 形態例においては、2 次モード励振パッチ 4 の中心点を中心とする円周部分と、アース板 3 とを円環導体 6 によって電気的に接続しているが、このような円環導体 6 に代えて、この円環導体 6 の円周上に対応する部分に沿って、第 1 誘電体基板 2 に多数のスルーホールを形成し、これらの各スルーホールによって 2 次モード励振パッチ 4 の中心点を中心とする円周部分と、アース板 3 とを電気的に接続するようにしても良い。このようにすることにより、上述した第 1 形態例と同様な効果を得ることができるとともに、製造を容易にして、製造コストを低減させることができる。

【0027】或いは円環導体 6 に代えて、円柱導体を用いてもその効果は同じであることは、説明を要しないであろう。また、上述した第 1 、第 2 形態例においては、第 1 誘電体基板 2 、 31 、第 2 誘電体基板 7 、 34 として、通常の材料（例えば、テフロン材）によって構成される誘電体基板を使用するようになっているが、紙などの材料によって中空の 6 角柱を構成し、これらを多数並べて接続したペーパーハニカム材などの誘電体基板を使用するようにしても良い。

【0028】このようにすることにより、第 1 、第 2 誘電体基板 2 、 7 、 31 、 34 の誘電体定数（比誘電率）をほぼ“1”まで下げて、アンテナの周波数特性を改善することができるとともに、マイクロストリップアンテナ 1 、 30 全体の重量を大幅に低減させることができる。また、上述した第 1 、第 2 形態例においては、1 点給電タイプのマイクロストリップアンテナを例にして、本発明によるマイクロストリップアンテナを説明しているが、2 点給電タイプのマイクロストリップアンテナにしても良い。このようにすることにより、円偏波の送受信を行なうようにすることができる。

【0029】以上の説明は、2 次モード励振パッチを使用した形態例について述べたが、一般的には、これは高次モード励振パッチで良く、どの高次モードを使用するかは設計条件によって選択することができる。更に、上記基本モードと高次モードの両者を同時に励振させ、両者の合成パターンを得ることも可能である。なお、第 1

形態例として説明した図 1 において、第 1 同軸ケーブル 15 の位置は、給電点 13 の位置によっては、円環導体 6 の内部に設置されることになるが、本発明の効果にはなんら影響はなく、むしろこのような場合は、円柱導体ではなく円環導体にしたメリットが生かせられる。

【0030】

【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、請求項 1 ~ 4 では、アンテナ全体を薄形にした簡単な構造で、半球面をカバーするのに充分な利得を確保することができ、これによってアンテナの占有面積、アンテナ重量を小さくすることができ、移動体用アンテナとして要求される特性にすることことができ、さらにアンテナ自身の放射パターンとして、初めからΣ（サム）パターンと、△（デフ）パターンとを持たせることができ、これによってパターン合成回路を使用することなく、極めて低い姿勢にすることができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】本発明によるマイクロストリップアンテナの第 1 形態例を示す断面図である。

【図 2】図 1 に示すマイクロストリップアンテナの斜視図である。

【図 3】(a) 及び (b) は図 1 に示すマイクロストリップアンテナの主ビーム方向例を示す模式図である。

【図 4】本発明によるマイクロストリップアンテナの第 2 形態例を示す断面図である。

【図 5】(a) 及び (b) は図 4 に示すマイクロストリップアンテナの主ビーム方向例を示す模式図である。

【図 6】従来から知られている多数のマイクロストリップアンテナを使用した多ビーム切換型アンテナの一例を示す斜視図である。

【図 7】図 6 に示す各マイクロストリップアンテナの構成例を示す断面図である。

【符号の説明】

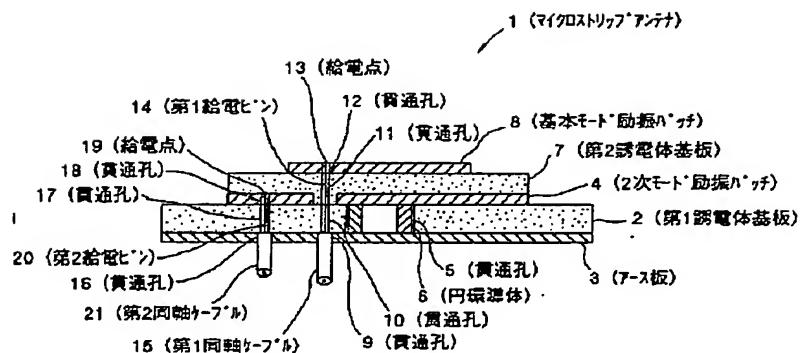
- 1 マイクロストリップアンテナ、 2 第 1 誘電体基板、 3 アース板、 4 2 次モード励振パッチ、 5 貫通孔、 6 円環導体、 7 第 2 誘電体基板、 8 基本モード励振パッチ、 9 、 10 、 11 、 12 貫通孔、 13 給電点、 14 第 1 給電ピン（給電回路）、 15 第 1 同軸ケーブル（給電回路）、 16 、 17 、 18 貫通孔、 19 給電点、 20 第 2 給電ピン（給電回路）、 21 第 2 同軸ケーブル（給電回路）、 25 主ビーム、 26 主ビーム、 30 マイクロストリップアンテナ、 31 第 1 誘電体基板、 32 アース板、 33 基本モード励振パッチ、 34 第 2 誘電体基板、 35 2 次モード励振パッチ、 36 、 37 、 38 貫通孔、 39 給電点、 40 第 1 給電ピン（給電回路）、 41 第 1 同軸ケーブル（給電回路）、 42 、 43 、 44 、 45 貫通孔、 46 給電点、 47 第 2 給電ピン（給電回路）、 48 第 2 同軸ケーブル（給電回路）、

11

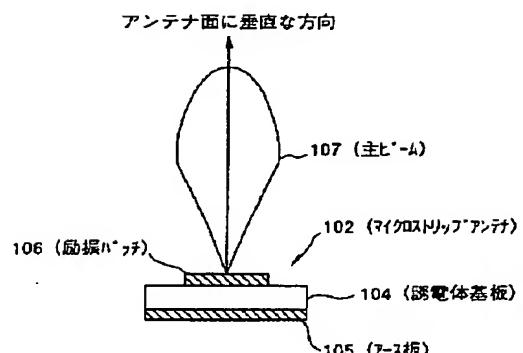
12

49 主ビーム、 50 主ビーム

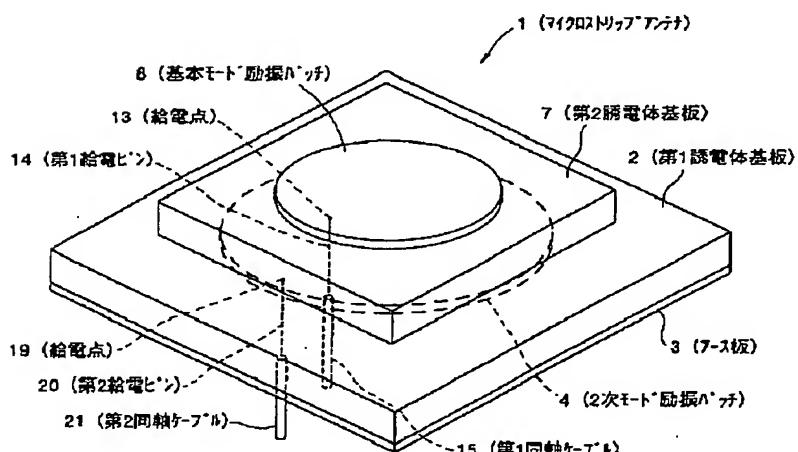
【図 1】



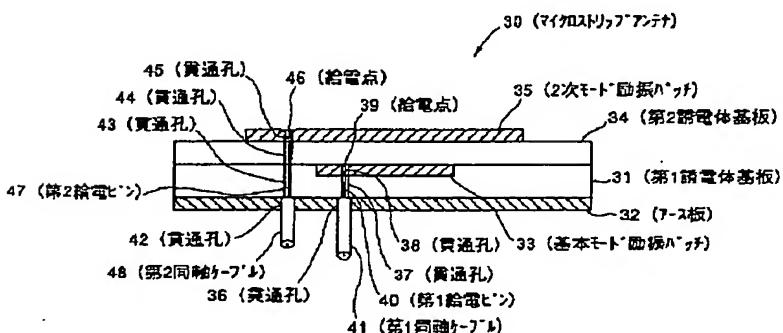
【図 7】



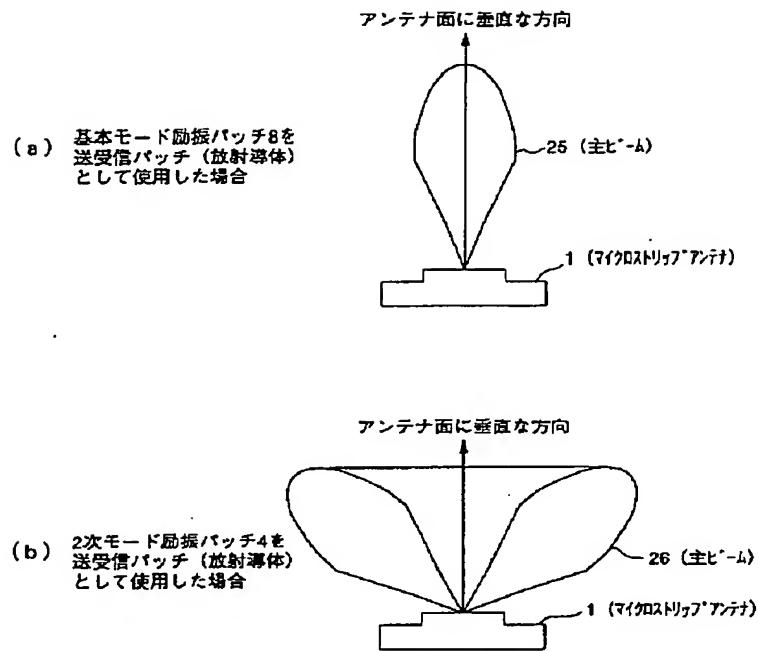
【図 2】



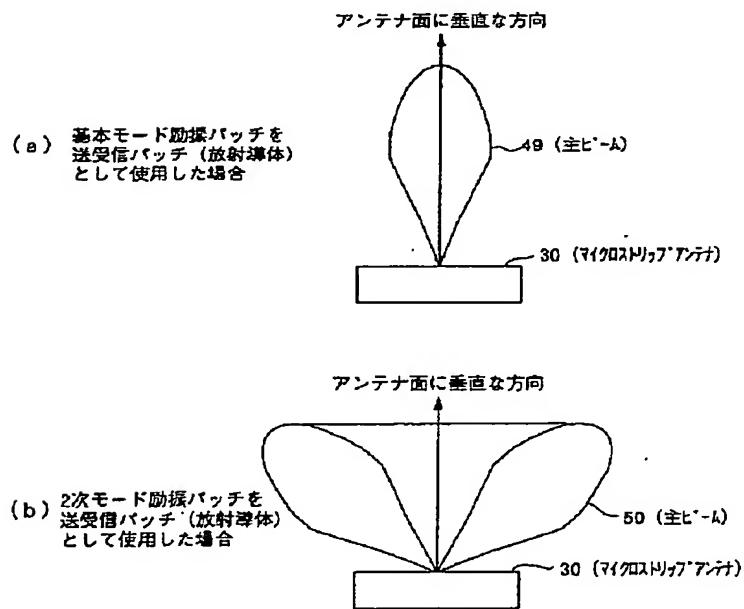
【図 4】



【図 3】



【図 5】



【図 6】

